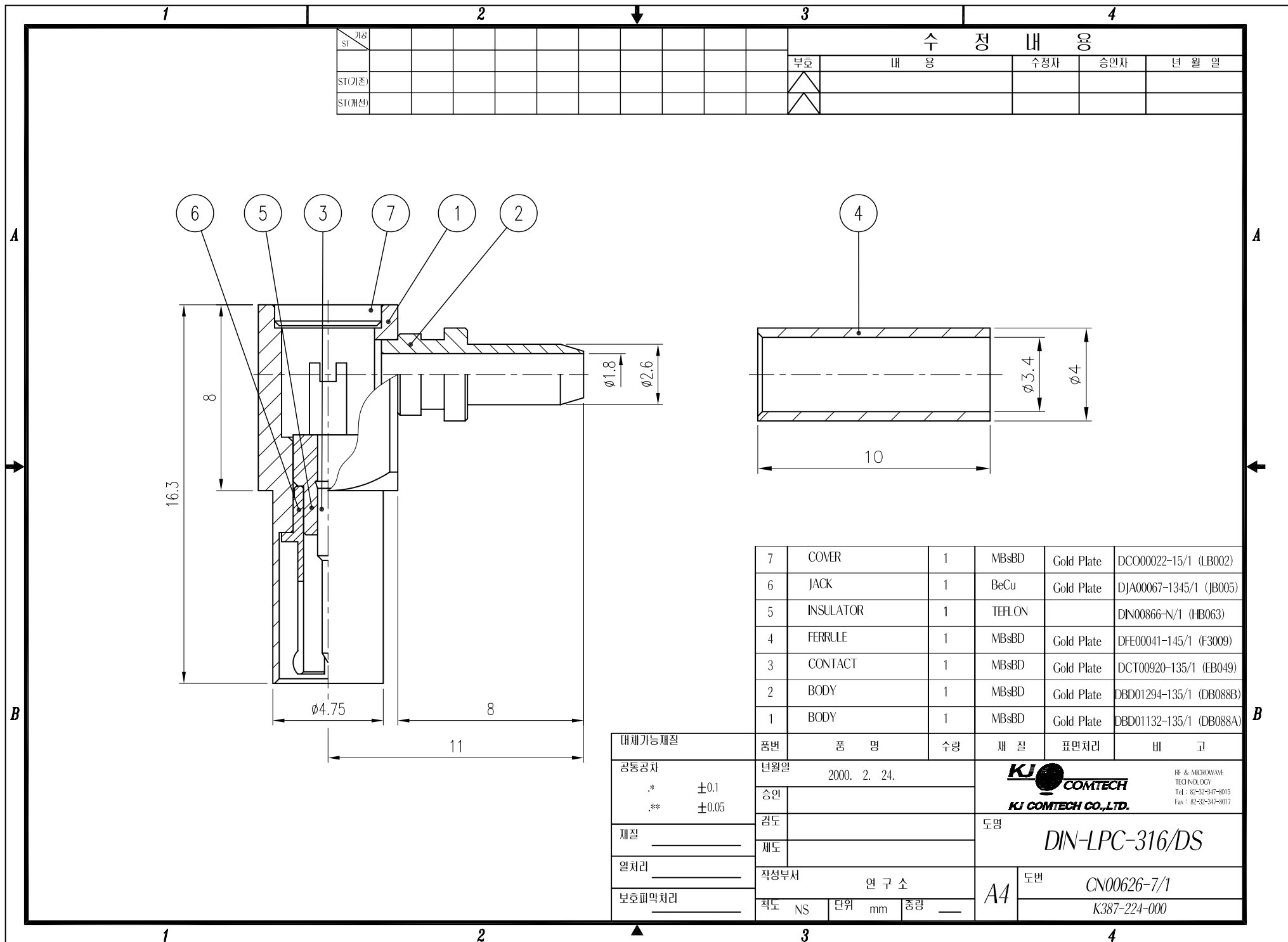




7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00022-15/1 (LB002)
6	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00067-1345/1 (JB005)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00866-N/1 (HB063)
4	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00041-145/1 (F3009)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00920-135/1 (EB049)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01294-135/1 (DB088B)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01132-135/1 (DB088A)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2000. 2. 24.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명	DIN-LPC-316/DS	
	재도						
열처리	작성부서 연 구 소				A4	도번 CN00626-7/1	
보호피막처리	적도 NS	단위 mm	총량			K387-224-000	